



## MWM-850/853

**MWM-850/853** 手动操作晶片贴膜装置提供了受控制和具重复性的晶片贴膜效果，最优的胶带张力和无气泡贴膜是让切割和个别处理程序能得到一致性和可靠性效果的关键性要素。以及牢固和灵活的设计，AE的手动操作晶片贴膜装置是一个多用途的晶片贴膜平台，所有的标准性能和选项能够适用于最大达12英寸的所有晶片和贴膜框架。



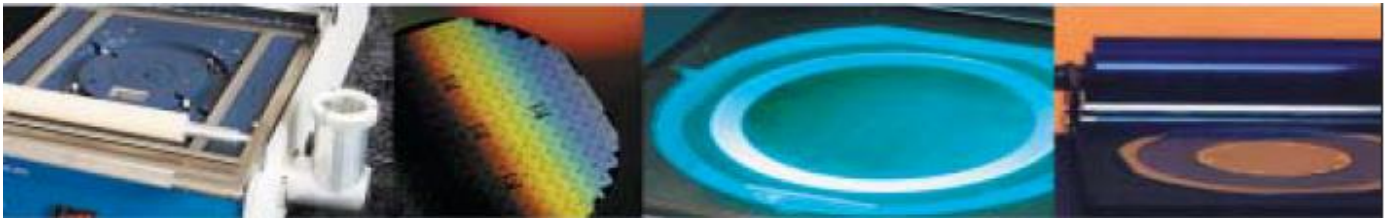
- ◆ 底盘适用于最大达12英寸的所有标准的晶片和晶片贴膜框架
  - MWM-850** (最大达8英寸)
  - MWM-853** (最大达12英寸)
- ◆ 简洁的桌面设计
- ◆ 内置式真空发生器
- ◆ 闭合回路，数字式平面温控功能选择
- ◆ 紫外胶带的功能选择
- ◆ 非接触式底盘贴膜功能选择
- ◆ 安全、简单和精准的操作

### 850/853的特点：

- 紫外胶带的垫片释放器：从系统中排出紫外胶带垫片，在管理生产废料时更加方便。
- 静电干扰消除器：离子发生器消除了贴膜过程中胶带上的静电电荷，从而保护了对静电敏感的设备。
- 非接触式的底盘（可按客户的要求定制）：在贴膜操作时减少了底盘和晶片之间的机械接触，可保护受过特殊处理的晶片表面。
- 晶片的校准定位装置（X, Y定心和校准的功能（可随应用的特殊要求而定制））：将晶片和贴膜框架定位在要求的位置上，通过可调整的定位螺丝进行校准和调节，可达到高重复的贴膜效果。
- 可按客户的要求定制底盘，以适用于特殊的操作要求。

### 技术规格

型号	MWM-850	MWM-853
尺寸	30.5*39.5*80cm	30.5*39.5*80cm
	12*15.5*31.5英寸	12*15.5*31.5英寸
重量	70磅 (32公斤)	100磅 (45公斤)
电压	110/220 Vac, 50/60Hz	
气压	5bar,CDA	



## 能按照客户的各类特殊需求来完成所有标准的贴膜应用

- 可调整压力的滚筒和平台基本可以处理所有的材料；
- 温度受控制的平台和张力调整杆为标准胶带提供了优化的应用要素；
- 在贴膜框架上多余的胶带将被锋利的削刀以旋转划圈的方式准确和安全的被切割和调整。
- 静电消除器的功能选择可消除切割胶带时所产生的电荷。静电放电腕带插座可在安装程序进行时保护对静电敏感的设备。
- 紫外胶带垫片释放的功能选择可帮助紫外胶带能轻易的被应用。
- 非接触式的底盘（可按客户的要求定制），可在胶带应用时保护表面敏感的材料，非接触式的底盘可支持晶片的边缘，同时被压缩的空气则像“枕头”一样有效的支持了晶片表面。
- 可按客户的要求定制：特别设计的底盘专为非标准的晶片/贴膜框架/胶带的组合应用而设计。



地址：浦东新区东方路1361号

电话：021-58397708/7706

林向华 13816003459

网址：[www.quest-tech.com.cn](http://www.quest-tech.com.cn)

邮箱：[dannylim@quest-technology.com](mailto:dannylim@quest-technology.com)